

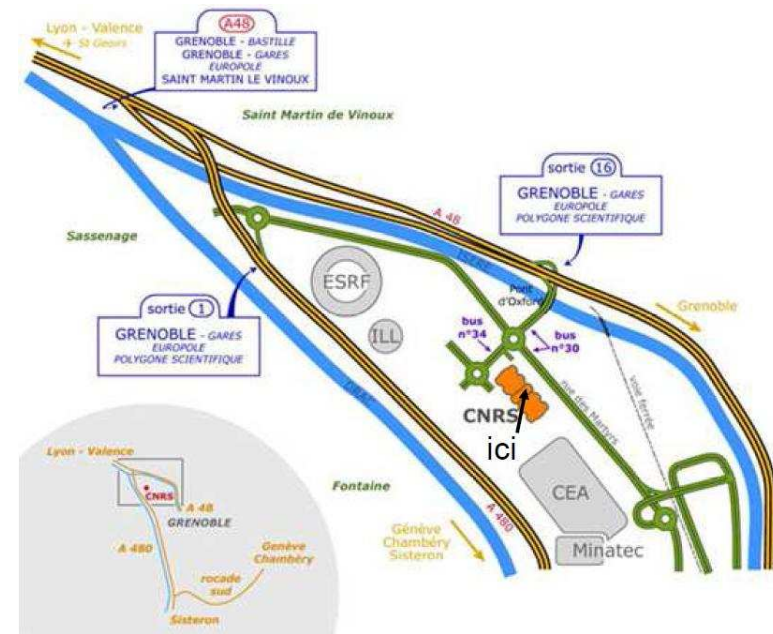
Soutenance de thèse Pierric GUEGUEN

Vous êtes convié à la soutenance de thèse de Pierric Gueguen, intitulée « **Etude des mécanismes mis en jeu dans le collage direct du cuivre. Application à l'intégration 3D des circuits** ».

Cette thèse a été effectuée au sein du Laboratoire de Transfert de Films et de Circuits (LTFC) du CEA-LETI-MINATEC et en collaboration avec l'IMEP-LAHC.

La soutenance publique aura lieu le **mercredi 29 Septembre à 10h30**, à **l'amphithéâtre des séminaires du CNRS** (2ème étage du bâtiment administratif) sur le site de **l'Institut Néel** (polygone scientifique), au 25 rue des Martyrs à Grenoble.

Un pot suivra la soutenance à la Maison des Magistères, en



Composition du jury

M. BRECHET Yves	D. R., SIMAP, Grenoble	Président
M. CLAVERIE Alain	D. R., CEMES, Toulouse	Rapporteur
M. FORTUNIER Roland	Prof. EMSE, Saint Etienne	Rapporteur
M. LEMITI Mustapha	Prof. INL, Lyon	Examinateur
Mme MORFOULI Panagiota	Prof. IMEP-LAHC, Grenoble	Directeur de thèse
Mme DI CIOCCIO Léa	Ing., CEA-LETI, Grenoble	Encadrant
M. MICHAILOS Jean	Ing., STMicroelectronics Crolles	Invité
M. RADU Ionut	Ing., SOITEC, Bernin	Invité

